

# サプライチェーン強靱化における データ連携の仕組みに関するガイドライン (車載半導体 関連) 0.1版 附属書C：データ項目

2026年6月  
経済産業省  
デジタルアーキテクチャ・デザインセンター (DADC)

# 各データ項目の説明 – 部品補足情報

管理する各データ項目の説明を示す。平時及び有事を問わず、データを提供する。(以降も同様)

#	データ項目	平時	有事	概要 (データ利用の目的・用途)	設定	備考
—	各者分類	—	—	各者の分類を用い、部品検索に必要な情報を管理する。 ・検索性の向上 ・データ利活用の促進	各者の分類方法 (各者分類) に準じて記載	プラットフォーム上で多品種の部品を扱う際にデータ利用者が部品の特徴を確認するための情報を管理する。
1	機能分類	○	○	機能を確認するための情報。	例. 電源用IC	各者内で表記統一する。
2	概要用途	○	○	用途を確認するための情報。	例. スイッチング電源用IC	
3	詳細用途	○	○	用途の詳細を確認するための情報。	例. 降圧・昇圧	
—	標準分類	—	—	全体で統一された分類を用い、部品検索に必要な情報を管理する。	全体で統一する分類方法に準じて記載	プラットフォーム上で多品種の部品を扱う際にデータ利用者が部品の特徴を確認するための情報を管理する。
4	機能分類	○	○	機能を確認するための情報。	—	業界で標準分類の策定・公開する。 半導体データプラットフォームでは、標準分類を任意登録とした。
5	概要用途	○	○	用途を確認するための情報。	—	
6	詳細用途	○	○	用途の詳細を確認するための情報。	—	
7	スペック情報	○	○	部品の詳細仕様を確認するための情報を示す。	例. データシートのリンク先情報	ユーザ企業が部品の詳細を確認するための情報を提示すること。

# 各データ項目の説明 – 新陳代謝促進

管理する各データ項目の説明を示す。

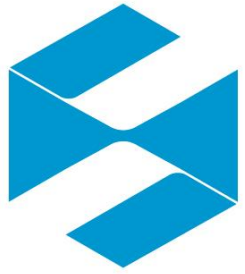
#	データ項目	平時	有事	概要（データ利用の目的・用途）	設定	備考
—	部品ステータス情報	—	—	仕入先の新陳代謝に関するニーズを把握する。	製品の状態に応じて適宜更新する。	情報の鮮度（1か月毎の更新等）が求められる。新規採用、及び、量産中の切替判断で用いる。
1	推奨・非推奨・要相談	○	—	新陳代謝に関するニーズを把握するための情報。	例. • RECOMMENDED（推奨） • NOT RECOMMENDED（非推奨） • Negotiable（要相談）	
2	部品ステータス	○	○	現在の製造に関するステータスの情報を示す。	例. • PREVIEW（開発中） • ACTIVE（生産中） • NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS（新規採用禁止） • LAST TIME BUY（最終オーダー） • OBSOLETE（生産終了）	
3	SOP（生産開始）	○	—	新規採用時の使用開始可能時期確認やEOL時の妥当性確認の参考情報とする。	製品ステータスが「ACTIVE（生産中）」の予定あるいは実績年月を設定する。	詳細情報が無い場合、年は確認している最も新しい生産年を設定。生産月については省略可。
4	EOL（販売終了）	○	—	EOL情報の適時把握による対応手番を確保するため。	半導体メーカー希望EOL年月あるいは最短EOL年月を設定する。 *1: LTB（最終発注）やLTS（最終出荷）ではない。	将来的にはPCN（製品変更通知）対応手番の短縮を図るために活用。
—	代替部品			代替部品を用いた開発の迅速化を図るため。		
5	有無	○	○	—	推奨代替部品の有無を設定。	
6	代替品型番	○	○	—	該当する部品を特定するための品番等の情報。	半導体データプラットフォームでは2型番を設定可能とする。
7	部品別参考情報	*1	*1	新陳代謝促進対象選定の参考情報を設定可能とする。	部品毎に異なる項目の取扱い及び型を拡張可能な構成で想定すること。（文字列、数値等）	半導体データプラットフォームの場合は「プロセスノード値（nm）」、「ウエハサイズ値（mm）」を設定可能とする。（新陳代謝に加え、輸出管理の該否判定で利用。）

\*1 対象となる情報による。

# 各データ項目の説明 – 安定調達・BCP

管理する各データ項目の説明を示す。  
半導体データプラットフォームの場合は、下記の項目を工程別に部品毎に4件までデータ登録を可能とした。

#	データ項目	平時	有事	概要（データ利用の目的・用途）	設定	備考
1	工程	○	○	部品を製造するまでの工程を示す。工程情報を示すことで、有事発生時に生産へ影響するまでのリードタイムの考慮に用いる。	部品毎に定義する生産工程を設定する。下記は、半導体データプラットフォームの場合の設定例を示す。 1. 前工程 2. 後工程 3. 検査工程	半導体データプラットフォームでは各工程、最大4か所までの管理とした。
2	メーカー名称	○	○	検索性の向上のため。	英語表記で設定する。	
3	生産地（国・地域）	○	○	地政学的リスクのアセスメントとセンシング及び、自然災害発生時の対象部品の早期特定のため。	英語表記で設定する。	
4	生産地（州・省・県）	○	○	自然災害発生時の対象部品の早期特定のため。	英語表記で設定する。	
5	生産地（市町村以降の住所）	○	○	自然災害発生時の対象部品の早期特定のため。	英語表記で設定する。	半導体データプラットフォームでは任意項目として管理。



経済産業省

*Ministry of Economy, Trade and Industry*



Digital Architecture  
Design Center